

各 位

上場会社名	株式会社 石井工作研究所
代表者	代表取締役社長 石井見敏
(コード番号)	6314)
問合せ先責任者	取締役総務経理部長 辻野治弘
(TEL)	097-544-1001)

業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成23年8月11日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成24年3月期第2四半期(累計)個別業績予想数値の修正(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	1,200	△140	△120	△125	△16.08
今回修正予想(B)	1,147	△247	△224	△194	△24.99
増減額(B-A)	△52	△107	△104	△69	
増減率(%)	△4.3	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成23年3月期第2四半期)	1,521	73	120	141	18.18

平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	3,350	50	100	90	11.58
今回修正予想(B)	2,977	△167	△124	△94	△12.09
増減額(B-A)	△373	△217	△224	△184	
増減率(%)	△11.1	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (平成23年3月期)	2,513	△195	△113	△118	△15.27

修正の理由

当社の売上げの9割強を占める半導体関連事業においては、半導体メーカーにおいて、サプライチェーンの立ち直りにより、生産活動は回復傾向にありますが、最終需要の下振れや在庫増加等により、半導体製造装置市場は調整局面に入っており、第2四半期累計期間の売上高は前回(平成23年8月11日)発表致しました予想を52百万円(減少率4.3%)下回りました。

損益につきましては、引き続き経費節減を図っておりますが、受注が伸び悩み、受注競争の激化による価格引下げ圧力が強く、営業損失は前回発表の予想に比べて107百万円増加し247百万円となりました。経常損失は前回発表の予想に比べて104百万円増加し224百万円となりました。四半期純損失は前回発表の予想に比べて69百万円増加し194百万円となりました。

通期の業績予想につきましては、引き続き厳しい受注競争を強いられませんが、第2四半期累計期間に比べて設備投資の動きがうかがえることから、売上高は増加するものと予想しておりますが、回復力は弱く、売上高は前回発表の予想を373百万円下回って2,977百万円(減少率11.1%)に修正いたします。

損益につきましては、受注条件が厳しく、営業損失は167百万円(前回予想比収益減少額217百万円)、経常損失は124百万円(同224百万円)、当期純損失94百万円(同184百万円)に修正いたします。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成23年8月11日発表)	—	0.00	—	10.00	10.00
今回修正予想	—	0.00	—	5.00	5.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績 (平成23年3月期)	—	0.00	—	10.00	10.00

修正の理由

前述のとおり今期の業績予想は、総力をあげて挽回に努めておりますが、収益を計上するまでに回復を望むことは困難な状況にあります。従いまして、期末配当につきましては、年間10円の配当を年間5円に減額いたしたいと存じます。

勿論、今後の業績推移や事業環境などを勘案し、年間10円に増額可能と判断できる状況となりました際には、改めてお知らせすることとさせていただきます。

※ 上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※ 将来の事象に関わる記述に関する注意

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以 上